

**国投证券股份有限公司**  
**关于深圳市深科达智能装备股份有限公司**  
**部分募投项目延期的核查意见**

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“深科达”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市和向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规的规定，对深科达部分募投项目延期事项进行了认真、审慎的核查，并发表意见如下：

**一、募集资金基本情况**

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市深科达智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1235号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司向不特定对象发行可转换公司债券360万张，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行合计募集资金总额为人民币360,000,000.00元，扣除承销及保荐费、律师费、审计费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（不含税）人民币9,180,886.77元后，实际募集资金净额为人民币350,819,113.23元。上述募集资金已全部到账，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了大华验字[2022]第000569号《验资报告》。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和《公司章程》《募集资金管理制度》等文件的规定，公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

## 二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《深圳市深科达智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》以及公司2022年9月7日披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-053），公司可转债募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	子项目名称	项目投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	深科达智能制造创新示范基地续建工程	惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目	15,504.83	11,766.50	11,466.43
2		半导体先进封装测试设备研发及生产项目	12,521.87	8,925.59	8,697.99
3	深科达智能制造创新示范基地	平板显示器件自动化专业设备生产建设项目	25,807.94	5,307.91	5,172.50
4	补充流动资金	/	10,000.00	10,000.00	9,745.00
合计		/	<b>63,834.64</b>	<b>36,000.00</b>	<b>35,081.91</b>

## 三、募投项目延期的具体情况及原因

### （一）本次延期募投项目具体情况

为了更好地确保本次募投项目的投资收益，结合行业发展及募投项目建设的实际情况，合理规划资源配置，确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司经审慎研究，在不改变募投项目实施主体、实施地点、投资内容、投资总额的情况下，拟对“惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目”、“半导体先进封装测试设备研发及生产项目”达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：

序号	募集资金投资项目	子项目名称	调整前达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
1	深科达智能制造创新示范基地续建工程	惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目	2024年8月	2026年8月
2		半导体先进封装测试设备研发及生产项目	2024年8月	2026年8月

### （二）本次部分募投项目延期原因

自募集资金到位以来，公司结合实际需要，审慎规划募集资金的使用，但由于公司募投项目建设周期较长，实际执行过程中受市场环境变化、行业发展变化以及订单情况等多方面因素影响，建设进度较预期有所延迟。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，经充分考虑、审慎研究，公司拟将“惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目”、“半导体先进封装测试设备研发及生产项目”达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 8 月。

#### 四、本次延期募投项目继续实施的必要性和可行性

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》的相关规定：超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到计划金额 50%，上市公司应当对该募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此公司对“惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目”、“半导体先进封装测试设备研发及生产项目”两个项目的必要性及可行性进行了重新论证。

##### （一）惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目

###### 1、项目实施的必要性

###### （1）丰富公司产品结构，提高市场份额

随着新一代 5G 通讯技术的应用普及所带来的信息传输便利的逐步显现，会同物联网时代的来临，将催生更多的显示端口应用场景，平板显示器件应用领域将被极大地拓宽；另外，随着各种显示技术的逐渐成熟及应用场景的不断分化，显示产业将迎来新一轮的蓬勃发展期。平板显示产业的发展情况，对生产专用设备在技术、工艺、性能、系统集成性等方面提出了新的更高要求，驱动面板产业新增产线设备投资及现有产线设备更新改造投资的增加，将进一步促进平板显示设备行业的发展。与此同时，AMOLED 技术已获得市场认可，广泛应用于智能手机、智能穿戴领域，并在车载显示、笔记本电脑、平板电脑等领域逐步渗透。Mini-LED 和 Micro-LED 等新型显示技术受到了越来越广泛的市场关注，已成为显示行业新星，渗透率将不断提升。本项目旨在向 Mini/Micro-LED 等新型高端显示设备进军，在现有平板显示设备产品基础上，先后对 Mini-LED 和 Micro-LED 精密组装检测设备进行研发生产，增加公司产品线，同时扩大公司的产品生

产规模,提高产品供应能力,促进公司新产品的产业化生产,丰富公司产品种类,在优化产品结构的同时也增强公司规模效应。规模化生产可有效提高生产效率,缩短生产和交货周期,进而更好更快地响应市场客户的需求。

## (2) 把握行业发展时代机遇

近年来全球平板显示产业迅速发展,消费电子产品市场需求及消费热点不断变化,显示器件市场规模不断增加,加大了专用设备的更换速度。未来随着 Micro LED 和量产性更佳的光波导器件进入市场,消费级 AR 市场将迎来进一步增长,也将给平板显示模组设备行业带来新的发展机会。公司有必要顺应行业技术发展趋势,坚持对行业新技术、新工艺、新产品的研究,保持自身在 LCD、OLED 平板显示器件自动化专业设备技术优势的同时,投入力量从事 Mini-LED、Micro-LED 等新兴平板显示领域的设备研制,不断推出满足市场需求的新产品,进一步增强公司的核心竞争力,奠定行业领先地位。

## 2、项目实施的可行性

### (1) 公司拥有较强的技术实力积累,为项目提供技术支持

公司长期专注于平板显示器件自动化专业设备研发和制造,技术优势突出。通过多年的持续努力,公司突破并掌握了精准对位、图像处理、运动控制、精密压合贴附等方面的核心技术,已具备提供涵盖 OLED 和 LCD 显示器件后段制程主要工序和工艺适用设备的能力,并拥有平板显示器件周边部件组装设备和检测设备的生产能力,能满足客户对于生产的特殊需求。

### (2) 公司拥有完善的团队管理体系,为项目提供制度保障

公司是一家专业智能装备制造制造商,拥有科学完整的研发、生产和销售运营体系,能够为客户提供公司相关自动化设备的整体解决方案。公司拥有完备的内部管理制度,包括采购、生产、质检、销售等各个环节。在研发方面,公司致力于依靠自主创新实现企业可持续发展,公司坚持以市场需求为导向的研发理念,注重技术的积累与创新,构建了完善的研发体系,紧随平板显示产业发展趋势形成了富有竞争力的研发创新能力。公司及时把握下游行业发展动向,结合终端消费者的需求变化趋势,确立了一系列前瞻式研发项目,保证了公司在日益激烈的市场竞争中的技术研发优势。

## （二）半导体先进封装测试设备研发及生产项目

### 1、项目实施的必要性

#### （1）丰富公司半导体封装测试设备产品类别，满足市场需求

半导体设备是整个半导体产业的重要支撑，从全球半导体设备行业来看，随着下游电子、汽车、通信等行业需求的稳步增长，以及物联网、云计算及大数据等新兴领域的快速发展，集成电路产业面临着新型芯片和先进制程的产能扩张需求，为半导体设备行业带来广阔的市场空间。目前半导体设备市场主要由欧美、日本等国家的境外企业所占据，我国半导体专用设备自给率低，严重制约了我国半导体产业的全面发展，大力推进半导体自主可控已是大势所趋，半导体设备正加速进入国产替代化阶段。中国是全球最大的电子终端消费市场和半导体销售市场，半导体产业的快速发展不断推动着半导体设备市场规模的扩大。本项目建设是在公司现有半导体封装测试设备基础上，研发新的半导体先进封装测试设备，丰富公司半导体封装测试设备产品类别，延伸产品线，进一步扩大公司业务范围，覆盖半导体封装测试更多环节，为客户提供更加多样化的产品选择方案，满足市场多样化需求。

#### （2）抓住市场发展机遇，提升公司市场竞争力

随着半导体封装测试市场规模不断增长，封装测试设备需求规模不断增加，半导体设备国产替代不断推进，为我国半导体行业提供了良好的发展机遇。根据 SEMI 预计在前端和后端市场的推动下，2025 年半导体设备的销售额将达到 1,240 亿美元的新高。本项目主要研发并生产半导体封装测试设备，属于国家产业政策鼓励和支持的项目。本项目实施是在有利的宏观政策环境下，抓住市场发展机遇，以封测设备为切入口，充分利用现有资源和能力，向市场提供多种先进的设备，提升公司市场竞争力的有力举措。

### 2、项目实施的可行性

#### （1）公司拥有强大的技术研发实力，为项目建设提供技术支持

公司长期专注于智能化设备的研发及制造，已经掌握了半导体封测设备生产所需的精密视觉对位技术、图像识别技术、机器人与视觉融合技术、压力精密控制技术核心技术。公司建立了完善的质量控制体系，积极建立健全研发体系，

设立研发中心，持续加大研发投入，保障公司研发实力维持在较高水准，为项目实施提供了有力保障。

## （2）公司拥有完备的人才储备和优质客户群体

公司高度重视人才引进与人才培养，建立了一套完善的“引、育、用、留”体系，公司形成了一支由研发技术人员、销售服务人员及核心管理人员组成的高度稳定的人才队伍。为吸引和留住人才，公司建立了良好的人才培养机制，实行了一系列科学的管理机制和激励机制，有力的调动了科研人员的积极性，确保了队伍的稳定，为公司未来发展奠定了良好基础，可有效保障项目的顺利实施。同时，公司致力于成为业界一流的智能制造装备企业，始终坚持以客户需求为中心，以客户满意度为宗旨，凭借日益精进的研发水平、领先的生产技术工艺、完善的销售服务、卓越的产品质量，在半导体封装测试设备领域，与扬杰科技、华天科技、通富微电等企业建立了合作关系，累计积累了众多优质客户群体。

综上，在行业发展前景、市场空间、技术积累、人才储备以及客户群体等多方有力支撑下，公司决定继续实施上述募投项目并将该项目实施期限进行调整。继续实施期间，公司将持续关注经营环境变化，并对募集资金投资进行合理安排，力求实现公司利益最大化。

## 五、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况下作出的审慎决定，仅涉及募投项目预计可使用状态日期的调整，未改变募投项目的实施主体、实施地点、投资内容、投资总额等，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合有关法律法规和中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

## 六、履行的审议程序

公司于2024年8月8日分别召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于可转债部分募投项目延期的议案》，同意公司将部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期。该事项无需提交公司

股东大会审议。

## 七、监事会意见说明

公司募投项目延期事项仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的实施主体、资金用途等，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，全体监事一致同意公司本次募投项目延期事项。

## 八、保荐机构核查意见

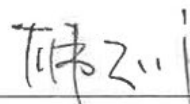
经核查，保荐机构认为，深科达本次部分募投项目延期事项，已经公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议分别审议通过，履行了必要的审议程序；符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定。公司本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据项目实施的实际情况做出的，符合公司经营需要，不会影响主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

综上，保荐机构对深科达本次部分募投项目延期事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于深圳市深科达智能装备股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



韩志广



赵跃



国投证券股份有限公司

2024年8月9日